



nexthardware.com

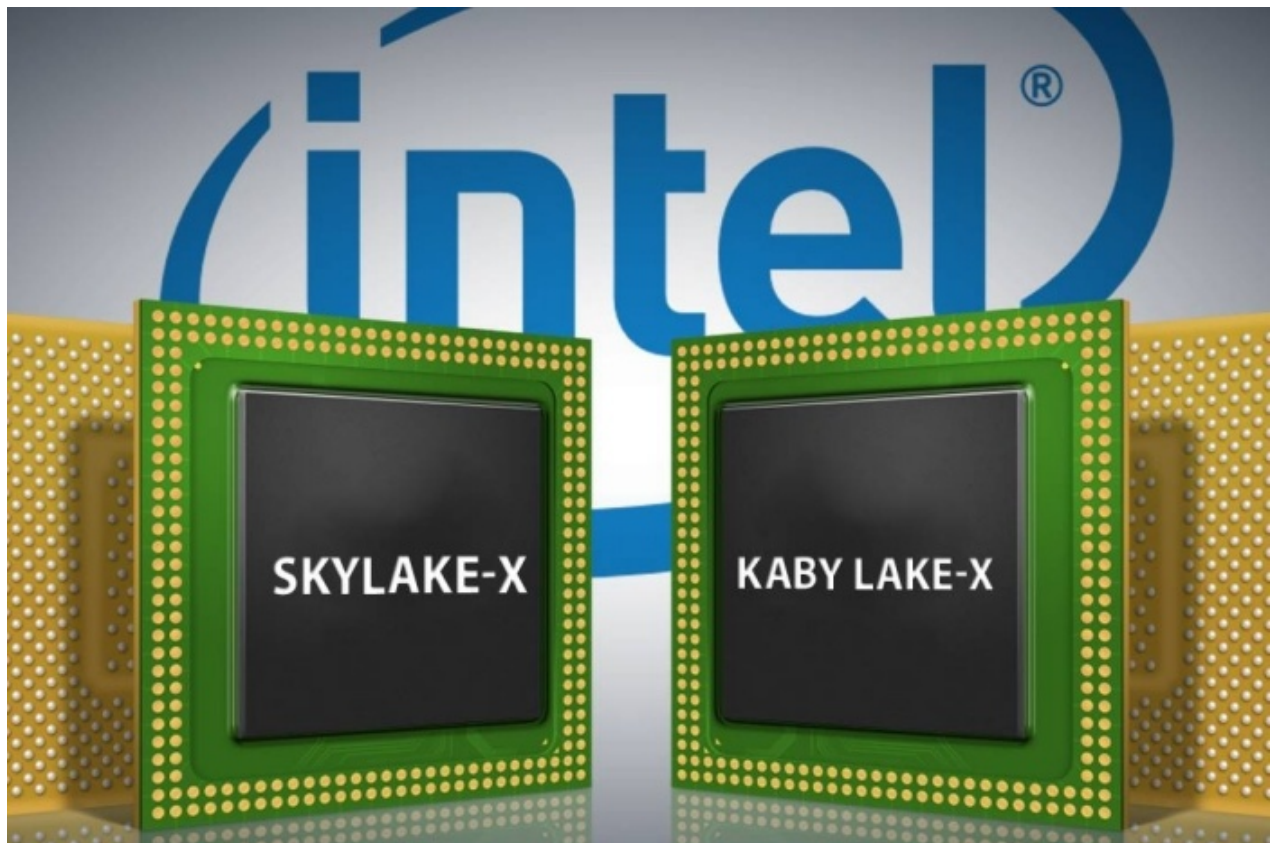
a cura di: Gian Paolo Collalto - giampa - 08-02-2017 10:30

Gli Intel Core i7-7740K e i5-7640K saranno Kaby Lake-X



LINK (<https://www.nexthardware.com/news/processor-chipset/7937/gli-intel-core-i7-7740k-e-i5-7640k-saranno-kaby-lake-x.htm>)

TDP da 112W e nessuna GPU integrata per le due future CPU su socket LGA 2066.



Confermata ormai l'esistenza dei due nuovi SKU Intel, che non usciranno certamente in concomitanza del lancio degli AMD Ryzen R7 1800X Black Edition, emergono nuovi particolari che vanno a rettificare in modo sostanziale quanto da più parti (noi compresi) [pubblicato \(/news/intel-prepara-le-contromosse-a-](#)

[ryzen-e-dopa-kaby-lake-7936/](#)) nella giornata di ieri, almeno secondo le fonti dei sempre ben informati ragazzi di [Wccftech \(http://wccftech.com/intel-core-i7-7740k-core-i5-7640k-amd-ryzen/\)](http://wccftech.com/intel-core-i7-7740k-core-i5-7640k-amd-ryzen/).

Modello CPU	Intel Core i5-7600K	Intel Core i5-7640K	Intel Core i7-7700K	Intel Core i7-7740K
Processo prod.	14nm+	14nm+	14nm+	14nm+
Cores/Threads	4/4	4/4	4/8	4/8
Base Clock	3,8GHz	4,0GHz	4,2GHz	4,3GHz
Boost Clock	4,2GHz	4,0GHz	4,5GHz	TBD
L3 Cache	6MB	6MB	8MB	8MB
Supporto memorie	DDR4 Dual Channel	DDR4 Quad Channel	DDR4 Dual Channel	DDR4 Quad Channel
Socket	LGA 1151	LGA 2066	LGA 1151	LGA 2066
TDP	91W	112W	91W	112W

Entrambe i nuovi processori apparterranno alla famiglia Kaby Lake-X differenziandosi dall'attuale lineup per la compatibilità con le future piattaforme equipaggiate con chipset Intel X299 e socket LGA 2066, il supporto alle DDR4 in modalità Quad Channel, l'assenza di IGP, un TDP di circa 112W ed una maggiore attenzione di Intel riguardo il TIM (Thermal Interface Material), ovvero la pasta termica posta tra die e HIS, che dovrebbe essere di qualità nettamente migliore per aumentarne la capacità in overclock.